

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成28年6月16日 (2016.6.16)

【公開番号】特開2014-225609(P2014-225609A)

【公開日】平成26年12月4日 (2014.12.4)

【年通号数】公開・登録公報2014-066

【出願番号】特願2013-104986(P2013-104986)

【国際特許分類】

H 0 5 K 7/20 (2006.01)

G 0 3 B 17/02 (2006.01)

G 0 3 B 17/55 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 7/20 F

G 0 3 B 17/02

G 0 3 B 17/55

【手続補正書】

【提出日】平成28年4月25日 (2016.4.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の外装部材と、
回路基板と、

前記第 1 の外装部材と前記回路基板との間に配置され、前記回路基板で発生した熱を前記第 1 の外装部材に伝達する伝熱部材と、

前記第 1 の外装部材の外装の少なくとも一部を覆うように前記第 1 の外装部材に組み付けられる第 2 の外装部材と、を備え、

前記伝熱部材は、前記第 1 の外装部材の前記第 2 の外装部材で覆われる部分で前記第 1 の外装部材に接続され、前記回路基板で発生した熱を前記第 1 の外装部材に熱を伝達することを特徴とする電子機器。

【請求項 2】

前記第 2 の外装部材は、前記第 1 の外装部材より熱伝導率が低い材料で形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の電子機器。

【請求項 3】

前記第 2 の外装部材は、前記第 2 の外装部材及び前記第 1 の外装部材より熱伝導率が低い材料からなる両面テープを介して前記第 1 の外装部材に組み付けられることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の電子機器。

【請求項 4】

前記伝熱部材は、前記第 1 の外装部材の前記第 2 の外装部材で覆われる部分で前記第 1 の外装部材に溶接されることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか一項に記載の電子機器。

【請求項 5】

前記溶接は、スポット溶接又はレーザ溶接であることを特徴とする請求項 4 に記載の電子機器。

【請求項 6】

前記第 1 の外装部材と前記第 2 の外装部材との間に設けられて、前記第 1 の外装部材と前記第 2 の外装部材とを電氣的に導通する導電部材を備え、

前記導電部材は、前記第 1 の外装部材と前記伝熱部材とが接続される位置とは異なる位置に配置されることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか一項に記載の電子機器。

【請求項 7】

前記第 1 の外装部材には、表面側に凸部が形成されるとともに、裏面側に前記凸部に対応する凹部が形成される刻印部が設けられ、

前記伝熱部材と前記刻印部の前記凹部とが溶接により電氣的に接続されることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか一項に記載の電子機器。

【請求項 8】

前記伝熱部材と前記凹部とが溶接された状態では、前記凸部の表面の溶接痕が除去されていることを特徴とする請求項 7 に記載の電子機器。